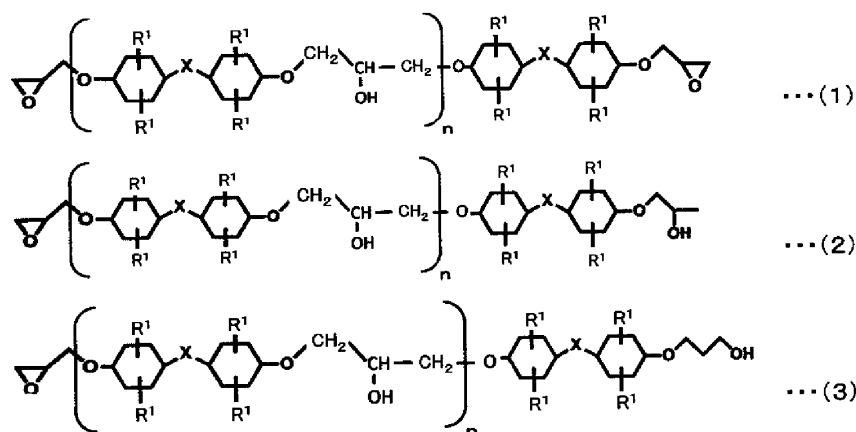


請求の範囲

[請求項1] 下記式（１）で示される構造のエポキシ樹脂（以下「エポキシ樹脂（１）」と称す。）と、下記式（２）で示される構造のエポキシ樹脂（以下「エポキシ樹脂（２）」と称す。）及び／又は下記式（３）で示される構造のエポキシ樹脂（以下「エポキシ樹脂（３）」と称す。）とを含むエポキシ樹脂組成物であって、エポキシ樹脂（１）とエポキシ樹脂（２）及び／又はエポキシ樹脂（３）の合計１００質量％中に、エポキシ樹脂（１）を８９．０～９９．９質量％、エポキシ樹脂（２）及び／又はエポキシ樹脂（３）を０．１～１１．０質量％含む、エポキシ樹脂組成物（Ａ）。

[化1]



上記式（１）、（２）、（３）中、Xは、直接結合、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{C}(\text{CF}_3)_2-$ 、 $-\text{S}-$ 又は炭素数１～２０の炭化水素基から選ばれる２価の連結基である。R¹は、水素原子、炭素数１～１０の炭化水素基又はハロゲン元素であり、互いに同一であっても異なってもよく、シクロヘキサン環上の隣接した炭素原子に結合した２つのR¹は、互いに結合して炭素数４～２０の環状構造を形成してもよい。nは０～２の整数である。

[請求項2] 前記式（１）～（３）において、Xがイソプロピリデン基であり、R

¹が水素原子であり、且つnが0である、請求項1に記載のエポキシ樹脂組成物（A）。

- [請求項3] 全塩素量（J I S K 7 0 4 3 - 3に準拠）が1 0 0 0 p p m以下である、請求項1又は2に記載のエポキシ樹脂組成物（A）。
- [請求項4] エポキシ当量が1 7 6 ~ 1 8 6 g / 当量である、請求項1 ~ 3のいずれか1項に記載のエポキシ樹脂組成物（A）。
- [請求項5] ハーゼン色数の値（A P H A値：I S O 6 2 7 1 - 2 : 2 0 0 4に準拠）が1 2以下である、請求項1 ~ 4のいずれか1項に記載のエポキシ樹脂組成物（A）。
- [請求項6] 請求項1 ~ 5のいずれか1項に記載のエポキシ樹脂組成物（A）1 0 0質量部に対し、硬化剤を0. 0 1 ~ 1 0 0 0質量部含むエポキシ樹脂組成物（B）。
- [請求項7] 請求項6に記載のエポキシ樹脂組成物（B）を硬化させてなる硬化物。
- [請求項8] 請求項6に記載のエポキシ樹脂組成物（B）を硬化させてなる電気・電子部品。
- [請求項9] 請求項6に記載のエポキシ樹脂組成物（B）を硬化させてなる光学部品。